

股票代码：688519

股票简称：南亚新材

南亚新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-002

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <div><div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div></div> |
| 参与单位名称 | 国投瑞银基金、华夏基金、平安基金、建信基金、国泰基金、海创基金、信达澳亚基金、长盛基金、长信基金、华泰保兴基金、九方智投、民生加银基金、华源证券、财通证券、东北证券、东方证券资管、东吴证券、国海证券、国金证券、国盛证券、国泰海通证券、湖北尚旌私募、华福证券、农银汇理、平安证券、山西证券、上海如仪投资、涛略投资、信达证券、长江证券、招商证券、浙商证券、中泰证券、中银国际证券等 |
| 时间 | 2025 年 06 月 27 日-2025 年 06 月 27 日 |
| 地点 | 南亚新材江西子公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长：包秀银 总经理：包欣洋 副总经理：席奎东 副总经理：刘涛 董事会秘书：张柳 财务总监：解汝波 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>问 1：公司布局从国内延伸到海外发展，请问公司高速材料在台湾及海外进展情况如何？与海外大厂合</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>作认证方面有何突破进展？</p> <p>答：公司布局国内市场的同时，积极布局海外市场，主要聚焦于伺服器与高速网通应用，持续推广旗下的 高速材料，特别是 NY6300S、NY6300SN、NY6666 以及 NY8888N 等核心产品。</p> <p>公司在台湾市场深耕多年，成立了海外技术推广和支持团队，并不断引进行业优秀人才全面布局，聚焦于伺服器与高速网通应用推广。目前已进入多家客户的设计阶段或正在进行导入认证。在海外其他市场方面，公司的高速材料能够支援包括 PCIe 5.0/6.0、800G / 1.6T Ethernet、AI Server 等高端应用。在 Ultra Low Loss I 等级材料，已被多家客户纳入既有平台测试。Intel/AMD 两大主流新品的各平台认证我司各等级都有亮眼的表现，且已开始通过</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>PCB 客户积极与全球 GPU 和 AI 计算技术为核心的知名科技公司展开产品的认证，为产品全面推广做好铺垫。此外海外生产基地泰国工厂也在有序推进中，未来将进一步优化公司作为全球供应链一环的角色。</p> <p>问 2：公司整体产能情况及未来规划？</p> <p>答：截至目前，公司已在上海、江西吉安、江苏海门、泰国巴真分别投建或规划生产基地。上海生产基地设有 N1-N3 工厂，N1-N2 工厂随着江西生产基地产能的释放，其因能耗、人耗高，效率低停产，N3 工厂设计月产能 80-90 万张左右（含 1 条试验线）。江西生产基地设有 N4 -N6 工厂，N4 工厂设计月产能 100 万张左右，已达产，N5 工厂设计月产能 120 万张左右，已达产；N6 工厂设计月产能也是 120 万张，继去年三季度释放月产能 30 万张后，今年 3 月末又新增投入月产能 60 万张，5 月末新增投入月产能 30 万</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>张，至此，N6 厂已全部建成投入。到今年年底公司整体月生产产能将达近 400 万张。江苏生产基地首个年产 360 万平米的高端 IC 封装材料智能工厂的各项建设工作有序推进中，预计到明年年底前建成投产。泰国工厂已购地并办理地契，公司将视自身及行业发展趋势和地缘政治变化推进投建进度。</p> <p>问 3：在汽车圈内，有个共识，新能源汽车上半场的电动化已经告一段落，下半场是智能化的争夺战。贵司在汽车智能化领域，材料有什么新的进展？</p> <p>答：公司在车载智能化的主力产品有：NY3170M、NY-A3HF、NY-A5HF、NY-A6HF。随着新能源汽车在国内的快速发展，已经从“电动化”迈向“智能化”。AI 技术正在重构汽车的智能化体验，已从“辅助工具”演进为“核心中枢”。这就意味着，对材料供应商来说，技术方案要兼具技术创新和成本优势。公司主推的车载智能化产品，从 Mid-loss 到 Very low loss，从 low CTE 到 Very low CTE，材料能力从高多层到 Anylayer，性能全方位适应，做到“商用一代、储备一代、预研一代”。</p> <p>问 4：贵司服务器，AI 服务器材料应用最新进展？</p> <p>答：NY6300S 全面进入多客户 PCIe Gen5 服务</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>器量产，PCIe Gen6 完成头部客户测评，进入产品预研阶段；AI 服务器突破多客户国产 GPU 方案，材料涵盖 M6-M8U 等级，全栈式适配 UBB,OAM 及 AI 系统主配板。</p> <p>问 5：终端客户占比情况？</p> <p>答：公司材料直接销售给 PCB 厂商，由其加工后再推广应用至终端，故公司很难精准统计自身产品对应终端应用比例，但结合自身产品的认证及客户群，大致可以判断公司主要应用领域为通讯、消费、车载、能源、工控医疗等。</p> <p>问 6：上波铜箔涨价，公司产品价格传导情况如何？</p> <p>答：公司针对上一轮铜箔涨价的传导，已陆续在 4 月至 5 月完成落地。</p> <p>问 7：IC 载板材料工厂建设资金需求？</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>答：公司在江苏南通海门建设的“年产 360 平米 IC 载板材料智能工厂建设项目”，总投资为 5.14 亿元，其中包括新增建设 2 条先进生产线及对应的配套设施建设。本项目今年 7 月总包进场，预计在明年底前建成投产。</p> <p>问 8：M8-M9 等级产品公司目前技术成熟度如何？高速下一代产品在原物料选择上是否已经存在技术瓶颈？比如需要采用 PTFE 等，公司是否有该方面的研究进展？</p> <p>答：目前我司 M8 等级材料已获得国内多家重要终端认证，现已实现小订单批量生产，在高阶产品上如 AI 服务器、交换机、光模块等领域得到应用；我司 M9 等级材料目前正在多家 PCB 客户测试中，积极向多家国内外终端推广认证。</p> <p>高速下一代产品所用原物料从开始设计阶段就与</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>上游玻布、树脂、铜箔供应商开展相关合作，并打造原物料稳定国产化供应链，避免国外关键原物料出现卡脖子问题。</p> <p>PTFE 材料我司已有相应的产品推出，会根据客户不同需求来应对。</p> <p>问 9：交换机方面公司客户突破进展如何？</p> <p>答：除了传统数据中心交换机，在互联网交换机市场需求大增，我司 NY-6300 系列，NY-P2 和 NY-P3 已在 400G 和 800G 交换机中应用，在新一代的 1.6T 预研产品 NY-P4 和 NY-P5 也参与其中。</p> <p>问 10：高速光模块和高速连接器近几年来发展迅速，南亚新材在高端光模块和高端连接器产品领域有什么样的布局。</p> <p>答：高端光模块和高端连接器的市场需求旺盛，400G，800G 光模块和连接器产品出货量都屡创新高。公司 NY-6300S/NY6300SN 等高速材料具有优异的电性能和可加工性，能够很好的适配</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>400G，800G 的高速光模块和连接器。另外针对现在最高端的 1.6T 光模块及 CPO 光电共封装产品南亚新材的 NY-6666/NY-8888 Low CTE 系列等材料相较于普通材料具有更低热膨胀系数能更好适配高多阶 HDI 技术与 Msap 制程，同时可以有效的提高 CPO 产品的良率。</p> <p>问 11：目前是否存在高端产能紧张的情况，以及产能转换的可能性？</p> <p>答：公司 N3-N6 工厂生产线均支持高速产品生产，且产能切换灵活，故高端产品预备产能充足。</p> <p>问 12：贵司 AI 服务器材料应用最新进展？国内智算 GPU 模组 224G 产品我司有无应对材料及开发进度？</p> <p>答：公司 NY6300S 全面进入多客户 PCIe Gen5 服务器量产，PCIe Gen6 完成头部客户测评，进入产品预研阶段；AI 服务器突破多客户国产 GPU 方案，材料含盖 M6-M8U 等级，全栈式适配 UBB,OAM 及 AI</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>系统主配板。智算 GPU 模组 224G 产品目前我司提供了 NY-8888Q 和 NY-9999Q Low CTE 解决方案配合客户预研。</p> <p>问 13：公司如何在当前环境下保持竞争优势？</p> <p>答：公司通过国产化、聚焦大客户战略以及强化高速产品优势来保持竞争力。我们不断提高基本盘的成本竞争力，提升大客户的占比，优化产能利用率；同时，持续推进产品结构转型，扩大战略盘产品的生产规模，保证性能稳定的基础上实现快速交付。此外，公司注重人才管理和培养，确保团队稳定性及应对市场竞争的能力。</p> <p>问 14：2025 年公司在载板材料和 HDI 材料方面取得了哪些进展？</p> <p>答：在载板材料领域，公司已针对存储类产品、RF 芯片(具备 low Dk/Low Df 属性)两大领域布局产品规划，开发的具有低 X、Y 轴热膨胀系数，优秀的</p> |
|--|--|

| | |
|----------|--|
| | <p>电性能，高刚性的性能特点的产品。在 HDI 材料领域，针对适用于智能终端应用的高集成化、高密度互联的电子材料，掌握配方核心技术，已开发出一系列具有优秀的电性能与尺寸稳定性，低热膨胀系数，高耐热，高可靠性的性能特点的 HDI 材料，综合性能指标处于国内领先水平。自 2024 年起，公司已开始对国内数家主要终端制造商所需的存储和手机材料进行认证测试。目前这些努力初见成效。</p> |
| 附件清单（如有） | |
| 日期 | 2025 年 06 月 27 日 |